



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 18683/18684

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2023 年第二季度自结财务报告

2023 年 7 月 31 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(31)日公告 2023 年第二季度自结财务报告。

2023 年第二季度财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 39.4 亿元，较前季增加 38%，较去年同期减少 26%
- ◆ 本季合并毛利率自前季的 11.4%回升到 20.1%；
本季营业净利率自前季的 -20.8%大幅改善到 -4.3%
- ◆ 本季营业净损为新台币 1.7 亿元，亏损较前季减少 71%
- ◆ 本季税后净损为新台币 2.76 亿元，亏损较前季减少 42%；
每股盈余为新台币 -0.23 元，前季为新台币 -0.95 元

2023 年第三季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第三季营收预计较前一季成长 low single digit 百分比。
- ◆ 第三季毛利率预计约为 mid-teens 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“2023年在渡过第一季的传统淡季之后，第二季合并营收为新台币39.4亿元，较前一季成长38%，较去年同期则减少26%。受惠于产能利用率回升的因素，营业毛利率从第一季的11.4%回升到20.1%，同时营业净利率也自第一季的-20.8%大幅改善到-4.3%。第二季税后净损为新台币2.76亿元，EPS为新台币-0.23元，亏损较前一季已显著收敛。

虽然上半年智能型手机全球出货量预期仍较去年同期呈现衰退的现象，但是综观第二季的营收成长动能，我们看到有越来越多中国手机PA客户的急单挹注，同时因应下半年高阶智能型手机新机发表的需求，相关客户也已经开始备货，因此Cellular PA及Wi-Fi PA在第二季都看到较大幅度的成长，是晶圆厂产能利用率回升到40%的主要关键，同时Infrastructure相对于第一季也呈现二位数成长，惟Optical营收则是较上一季下滑。

时至今日，不仅地缘政治所引发的战争或贸易冲突仍影响着我们，通货膨胀而导致的经济衰退也持续削弱了终端消费力道，首当其冲的尤其是过去世代演进快速的智能型手机市场，同时也冲击着相关基础建设的布建进度。我们直到最近才终于看到智能型手机市场有些许回升的迹象，不过目前还无法断言延续超过一年的终端库存调整已接近尾声。稳懋一直是客户最佳的代工合作伙伴，尽管景气低迷需求不振，在这段期间，我们的策略一直是持续投入研发资源，与客户紧密合作并了解客户的需求以提升客户竞争力，就是为了要协助客户掌握复苏的契机，以维持客户及我们的市场地位，一起度过景气的寒冬。

展望第三季，我们预期营收将较前一季成长 low single digit 百分比，毛利率则预计约为 mid-teens 的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于1999年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及3D感测领域中，稳懋更以MMIC生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。